



奇景光電 SID Display Week 2026 亮相業界領先超高對比 雙邊自發

光 LCoS 微型顯示器

突破性 LCoS 微型顯示器推動新一代 AR 眼鏡應用

【台灣台南，2026 年 4 月 22 日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（22）日宣布，將於 Display Week 2026 發表最新高對比微型 LCoS 微型顯示器技術，展現顯著提升的對比度表現、更優化的光學效率，以及專為新一代 AR 眼鏡所打造的創新先進系統。

Display Week 是由國際資訊顯示學會（SID）所主辦，是顯示產業最具指標性的研討會與展覽之一，將於 2026 年 5 月 3 日至 8 日在美國洛杉磯舉行。奇景光電資深技術經理陳冠宇博士將於 5 月 6 日研討會第 36.5 場次，以「High-Contrast Dual-Edge Color-Sequential Front-lit LCoS with Local Dimming Concept for AR Glasses」為題，發表專題演講。

奇景獨有的雙邊自發光 LCoS 微型顯示器（Dual-Edge Front-lit LCoS Microdisplay），具備卓越的光學效率，能將照明光學元件與 LCoS 面板整合於極致微型的模組中，整體體積僅 0.09 c.c.、重量僅 0.2 公克，目標亮度達 35 萬尼特，並在總功耗僅 200 毫瓦之下實現 1 流明光輸出。奇景最新的 LCoS 解決方案，搭配 720×720 解析度與精巧外型設計，在重量、解析度、影像品質、尺寸、功耗與成本之間取得最佳平衡。

奇景透過專有的材料與製程優化，將 LCoS 顯示器的 FOFO 對比度（Full On Full Off Contrast）由 250：1 顯著提升至 450：1，大幅提升影像清晰度與可讀性，在各種具挑戰性的光照環境下仍呈現優異表現。結合奇景最新開發的動態光調控（Dynamic Light Modulation; DLM）技術，FOFO 對比度進一步提升至超過 1000：1，同時可有效消除在低亮度或昏暗環境下常見的明信片效應（Postcard Effect）。綜合各種優異特性，奇景最新的 LCoS 顯示器，特別適合輕量化、可全天候配戴的 AR 穿戴式裝置。

奇景光電執行長吳炳昌表示，延續去年在 Display Week 2025 首度發表雙邊自發光 LCoS 微型顯示器的重要里程碑，奇景今年再度推出在對比表現、動態範圍及系統整合等全面升級的解決方案，使奇景朝向大規模量產擴增實境眼鏡的理想微型顯示器，邁出實質性的一步。

奇景光電誠摯邀請業界先進蒞臨 318 攤位參觀交流。如欲安排會議或攤位導覽，敬請聯繫 carol.lin@himaxdisplay.com。

關於奇景光電：

奇景光電股份有限公司（納斯達克代號：HIMX）為一個專注於影像顯示處理技術之 IC 設計公司。本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品廣泛應用於電視、桌上型電腦顯示器、筆記型電腦、手機、平板電腦、汽車、電子紙裝置、工業顯示器及其他多種消費性電子產品。其中，奇景光電更是全球車用顯示器解決方案的領先創新者，車用驅動 IC 市佔率全球第一，提供完整方案包括傳統驅動 IC、先進的觸控顯示整合晶片（TDDI）、分區調光時序控制晶片（Local dimming Tcon）、車用超大尺寸觸控顯示技術（LTDI）以及 AMOLED 顯示器技術。奇景光電也是 tinyML 視覺人工智慧及光學相關產品領導者，其專屬的 WiseEye™ 超低功耗 AI 智慧感測，整合自家超低功耗 AI 處理器、全時（Always-On）CMOS 影像感測器，和基於 CNN 的 AI 演算法，已廣泛用於消費電子及 AIoT 物聯網等相關領域。奇景光電並率先投入繞射晶圓級光學鏡頭、矽控液晶光閥（LCoS）微型顯示器和 3D 感測解決方案的技術開發，應用於各式 AR、VR 及元宇宙等領域。此外，奇景光電也提供其他產品，包含觸控面板控制 IC、AMOLED IC、LED 驅動 IC、電子紙驅動 IC、電源管理 IC、CMOS 影像感測器，滿足多種顯示器需求。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為 2,200 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國與美國。至 2026 年 3 月 31 日為止，奇景光電在全球已取得 2,564 項專利，尚有 331 項專利正在申請中。

<https://www.himax.com.tw/zh/company/>

奇景光電聯絡人：

刁玉苹 / Karen Tiao

投資人關係與公共關係部門主管暨發言人

hx_ir@himax.com.tw

奇景光電股份有限公司

Himax Technologies, Inc.

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2025 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。